

HY17P60B Series BIE應用注意事項

HYCON FAE Dept. 2022.01.26

TOPIC

前言

產品型號

注意事項

建議方案



前言

◆針對HY17P60B產品在使用BIE功能時的注意事項說明, 並提出建議方式。

產品型號

- ◆此應用注意事項適用以下產品型號
 - HY17P60B 系列產品

型號: HY17P60B-D000

HY17P60B-L064

HY17P60B-NS32

注意事項

◆硬體部份

- 使用8.5V外灌VPP電壓進行BIE燒錄時,周邊電路可能會造成電壓下降,導致BIE燒錄失敗,故建議使用8.6V~8.7V操作。
- 燒錄過程必須確保COMO保持低電位,以下提供兩種方式:
 - ➢ 將COM0外接一個下拉電阻到VSS,建議為0Ω~1MΩ,該電阻 值以不影響LCD顯示為主。
 - ➤ 將另一個沒有使用的引腳與COMO短路,進入BIE函式前,關 閉LCD顯示再把該引腳設置成輸出低電位;離開BIE函式後, 關閉該引腳輸出模式再開啟LCD顯示,避免LCD顯示異常。

注意事項

◆軟體部份

- 不論採用內部昇壓或外灌VPP電壓方式進行BIE燒錄時,一定要使用HYCON所提供的『HY17P60BWR3.lib』或『17P60BWR3.obj』裡的函式進行BIE燒錄
- 當燒錄完成後需延遲300mS再重新設定LCD相關暫存器,才可以在正常模式下使用。(外灌VPP電壓方式需移除外灌電壓才算燒錄完成,再進行延遲300mS)
- 操作BIE讀寫前必須關閉GIE中斷

建議方法-1

- ◆ BIE操作時必須使用HYCON所提供的BIE燒錄函式庫:
 - Demo Code包含4個檔案
 - BIE_LVD_ASM BIE_EXTVPP_ASM
 BIE_LVD_C BIE_EXTVPP_C
 - 內部昇壓可參考範例程式BIE_LVD_ASM或BIE_LVD_C
 - 外灌VPP可參考範例程式BIE_EXTVPP_ASM或BIE_EXTVPP_C

建議方法-2

◆採用內部昇壓方式進行BIE燒錄時,一定要使用HYCON 所提供的『LV17P60BWR3』函式進行BIE燒錄。範例:

C Language	ASM Language
Address=0000,Data=0xAA11	Address=0000,Data=0xAA11
result=LV17P60BWR3(0,0,0xAA,0x11);	CLRF BIEARH CLRF BIEARL MVL 0AAH MVF BIEDRH,F,A MVL 11H MVF BIEDRL,F,A call LV17P60BWR3BIE nopf LV17P60BWR3BIE BTSZ WREG,0,A
Return 0= pass, 1= VDD<2.75V, 2= VPP<8.5V	WREG= 0 pass, =1 fail

建議方法-2

◆ 採用**外灌VPP電壓**方式進行BIE燒錄時,一定要使用 HYCON所提供的『EXT17P60BWR3』函式進行BIE燒錄。 範例:

C Language	ASM Language
Address=0000H,Data=0xAA11	Address=0000H,Data=0xAA11
result=EXT17P60BWR3(0,0,0xAA,0x11);	CLRF BIEARH CLRF BIEARL MVL OAAH MVF BIEDRH,F,A MVL 11H MVF BIEDRL,F,A call EXT17P60BWR3BIE nopf EXT17P60BWR3BIE BTSZ WREG,O,A
Return 0= pass, 1= VDD<2.75V, 2= VPP<8.5V	WREG= 0 pass, =1 fail



Thank you

Sales@hycontek.com